



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

臻鼎科技控股 (4958 TT)

2023年第3季營運成果

2023年11月6日

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



簡報大綱

- 1 2023年第3季營運成果
- 2 策略布局
- 3 IC載板營運規劃與執行



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

2023年第3季營運成果

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外
季變化 (%) 年變化 (%)

	3Q23	2Q23	3Q22	季變化 (%)	年變化 (%)
營業收入	41,919	23,537	50,004	78.1%	-16.2%
營業毛利	8,583	2,123	12,986	304.3%	-33.9%
營業毛利率	20.5%	9.0%	26.0%	+11.5ppts	-5.5ppts
營業費用	5,008	4,011	4,919	24.9%	1.8%
營業利益	3,575	(1,888)	8,067		-55.7%
營業利益率	8.5%	-8.0%	16.1%	+16.5ppts	-7.6ppts
營業外收入及支出	222	1,393	345	-84.0%	-35.5%
本期淨利	3,349	150	7,172	2,127.3%	-53.3%
淨利率	8.0%	0.6%	14.3%	+7.4ppts	-6.3ppts
歸屬於母公司之淨利	2,271	(90)	4,985		-54.4%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	2.40	-0.09	5.27		
營運活動之現金流入	5,143	3,471	8,410	47.8%	-39.0%
資本支出	4,801	6,758	8,217	-29.0%	-41.6%
現金及約當現金 ⁽²⁾	59,979	59,916	48,957	0.1%	22.5%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	10.0%	0.5%	23.8%	+9.5ppts	-13.8ppts

附註：(1) 2023年前三季加權平均流通在外股數為944,956仟股。(2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。

(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

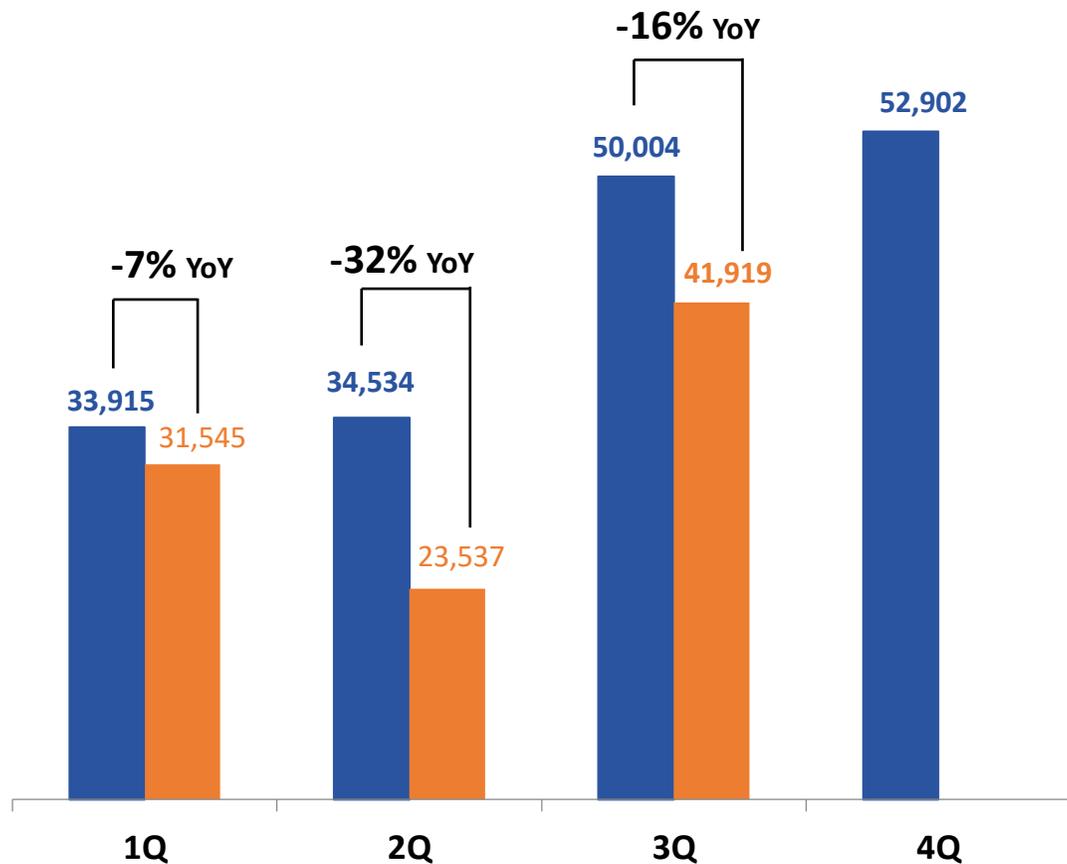
	1-3Q23	1-3Q22	年變化 (%)
營業收入	97,002	118,454	-18.1%
營業毛利	15,781	25,975	-39.2%
營業毛利率	16.3%	21.9%	-5.7ppts
營業費用	12,875	12,222	5.3%
營業利益	2,905	13,753	-78.9%
營業利益率	3.0%	11.6%	-8.6ppts
營業外收入及支出	1,298	1,995	-35.0%
本期淨利	4,362	13,678	-68.1%
淨利率	4.5%	11.6%	-7.0ppts
歸屬於母公司之淨利	2,685	9,492	-71.7%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	2.84	10.04	
營運活動之現金流入	20,360	29,853	-31.8%
資本支出	19,485	23,462	-20.0%
現金及約當現金 ⁽²⁾	59,979	48,957	22.5%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	4.4%	15.1%	-10.7ppts

附註：(1) 2023年前三季加權平均流通在外股數為944,956仟股。(2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。

(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

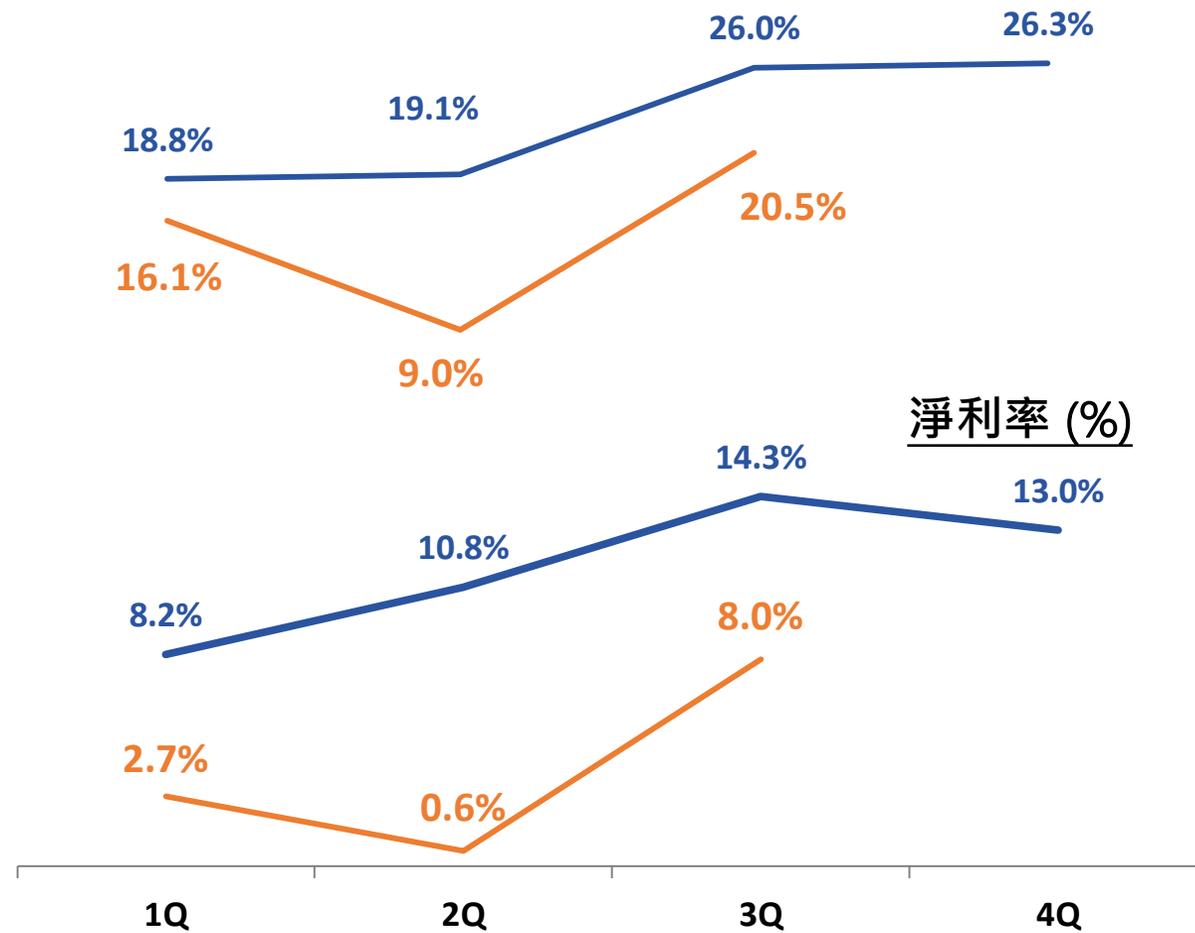
營業收入

■ 2022 ■ 2023 單位：新台幣佰萬元

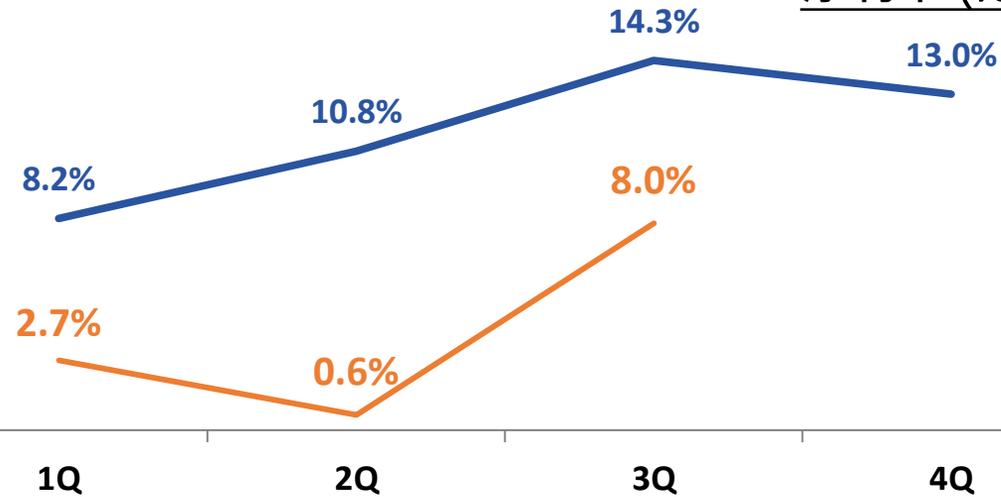


毛利率 (%)

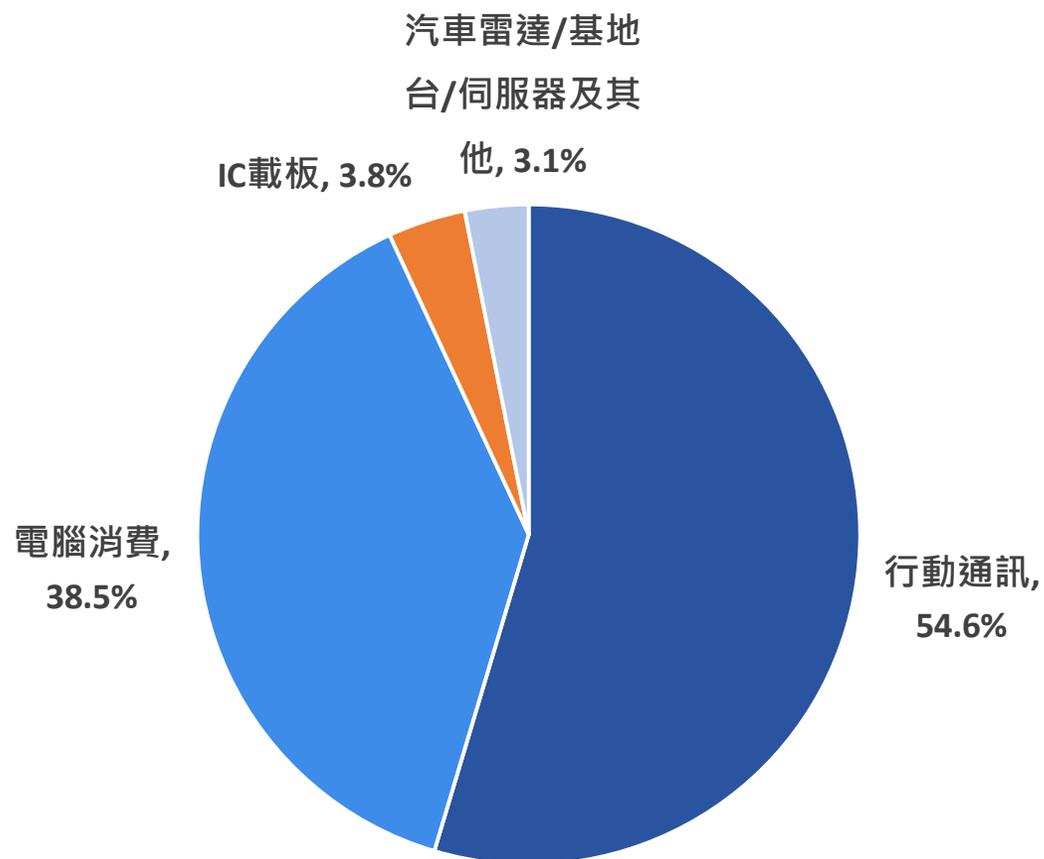
— 2022 — 2023



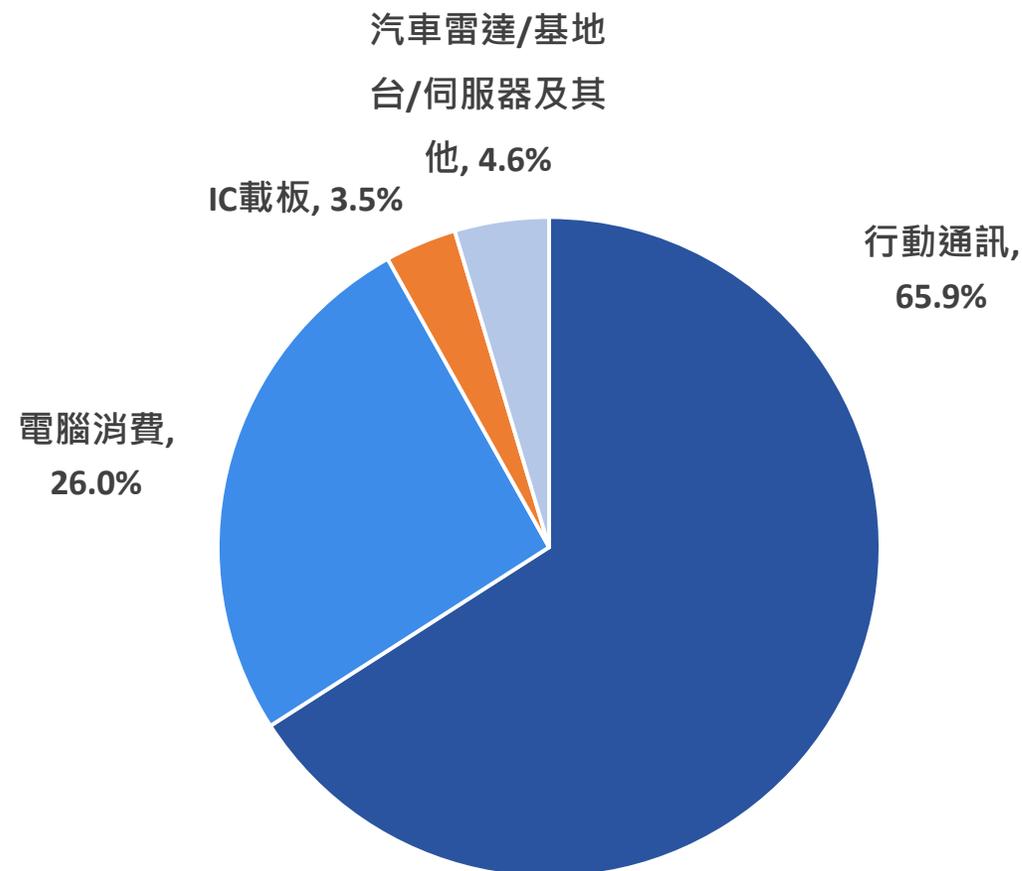
淨利率 (%)



1Q-3Q22 營收新台幣1,185億



1Q-3Q23 營收新台幣970億



資產負債表及重要財務比率

	2023-9-30		2022-9-30		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	59,979	24.2%	48,957	21.3%	11,022	+2.9ppts
應收款項	32,141	13.0%	36,326	15.8%	-4,185	-2.8ppts
存貨	22,311	9.0%	24,053	10.5%	-1,742	-1.5ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	112,780	45.5%	99,514	43.3%	13,266	+2.2ppts
資產總額	247,800	100%	229,707	100.0%	18,093	
借款	51,640	20.8%	46,515	20.3%	5,125	+0.6ppts
應付款項	44,196	17.8%	39,774	17.3%	4,422	+0.5ppts
負債總額	113,329	45.7%	101,874	44.3%	11,455	
股東權益總額	134,471	54.3%	127,833	55.7%	6,638	-1.4ppts
重要財務比率						
平均收現日數(天)	87		85		2	
平均銷貨日數(天)	72		65		7	
流動比率(倍)	1.41		1.52		(0.11)	
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.21		1.70		(0.49)	

附註：(1) 2023年9月30日流通在外股數為944,956仟股。(2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。

(3) 不動產、廠房及設備包含投資性不動產。(4) 資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

單位：新台幣佰萬元

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
營業收入	44,280	55,369	64,483	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356
營業毛利	6,993	10,775	11,894	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888
本期淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535
母公司淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197
折舊及攤銷	3,008	3,375	3,742	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638
每股盈餘 (元)	3.30	5.49	7.41	9.12	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02
每股股利 (元)	1.50	2.50	3.00	3.67	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00
分派比率 (%)	45.5%	45.5%	40.5%	40.2%	45.9%	51.3%	51.3%	42.5%	45.3%	50.6%	49.0%	40.0%
現金及約當現金 *	4,084	8,756	10,016	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599
不動產、廠房及設備	27,097	26,637	27,843	30,073	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814
資本額	6,699	7,034	7,386	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470
股東權益報酬率 (%)	15.34%	21.27%	23.77%	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%
負債比率 (%)	67.03%	66.28%	64.06%	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



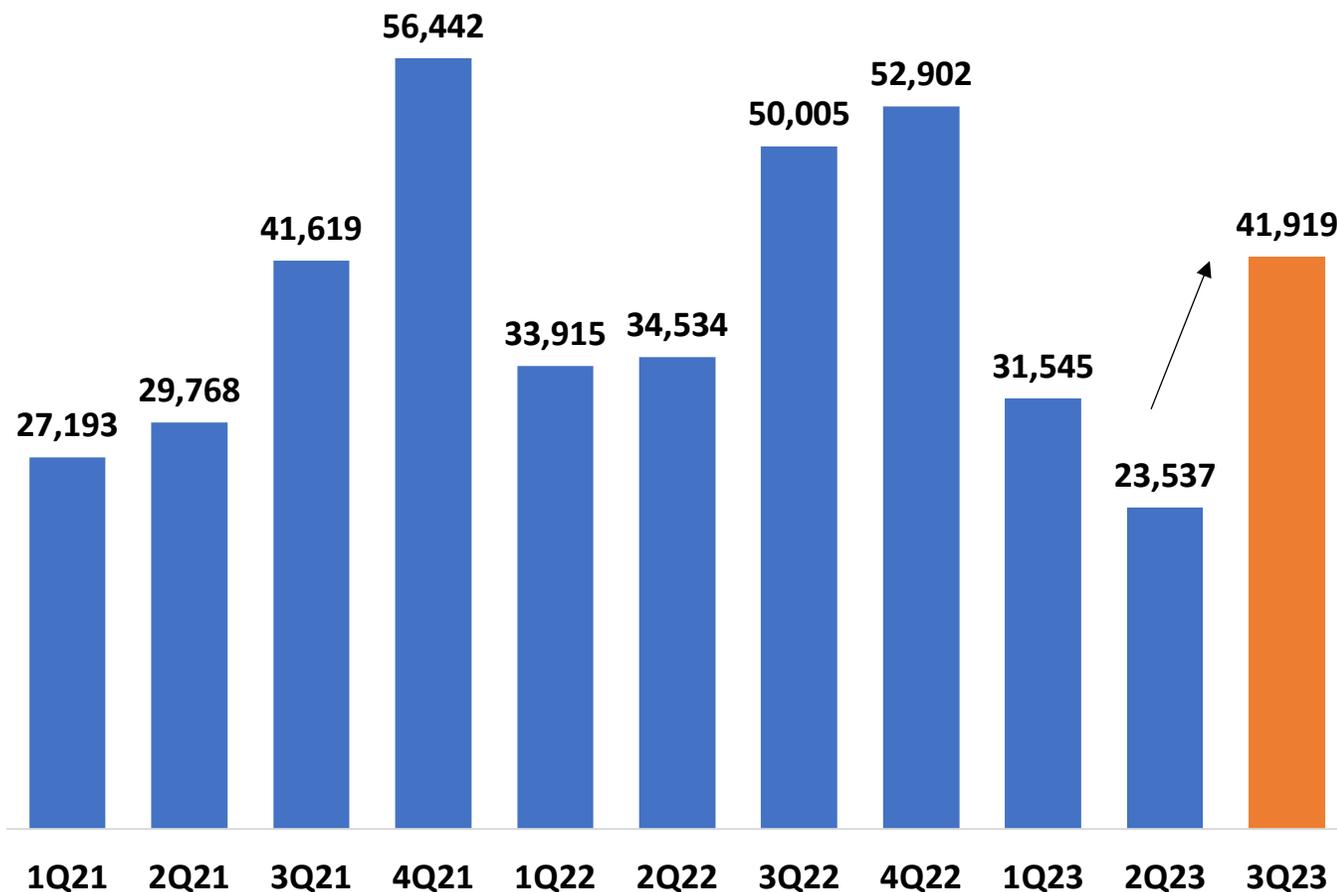
臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

策略布局

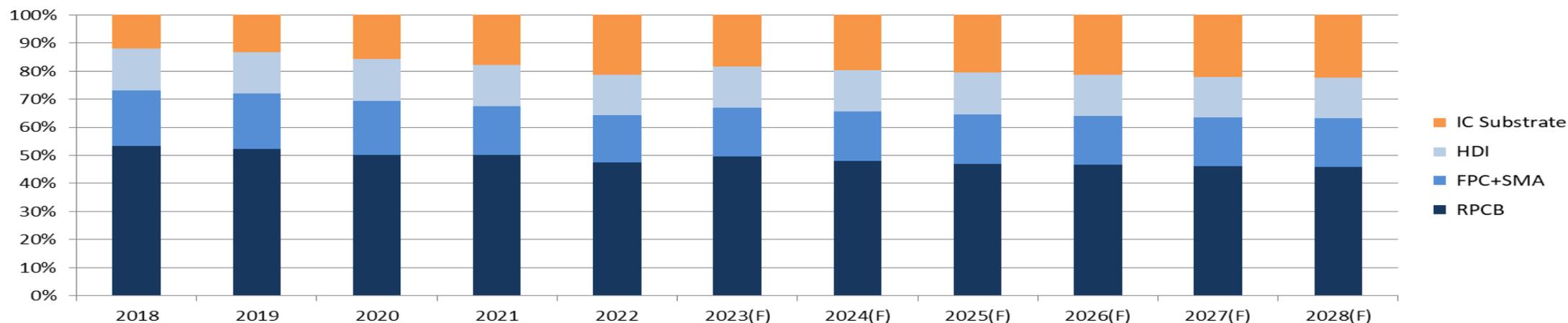
臻鼎季度營收

單位：新台幣佰萬元



- **1H23營運面臨逆風，專注產品開發與營運效率優化：**受到消費性電子需求不振，及客戶新舊產品轉換期影響，臻鼎營收隨產業趨勢呈現年減。然而於此期間，公司專注產品開發與營運效率優化，具體效益包含行動通訊產品毛利率在上半年不景氣之中仍實現年增。
- **2H23預期將溫和復甦：**在客戶新品備貨挹注下，3Q23行動通訊與電腦消費營收季增超過八成，同時IC載板及汽車/基地台/伺服器營收亦雙位數季增，整體產能利用率維持高檔，下半年公司營運將溫和復甦。

各類PCB市場規模預期明年重回成長軌道



單位：百萬美元

產品	項目	2018	2019	2020	2021	2022	2023(F)	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2023-2028 CAGR
RPCB	產值	33,225	31,969	32,674	40,641	38,720	34,542	34,986	36,576	39,025	41,768	42,486	4.20%
	佔全球比	53.20%	52.10%	50.10%	50.20%	47.40%	49.69%	47.98%	47.04%	46.61%	46.23%	45.97%	
FPC+SMA	產值	12,395	12,195	12,483	14,058	13,842	12,032	12,813	13,644	14,530	15,473	15,860	5.70%
	佔全球比	19.90%	19.90%	19.10%	17.40%	16.90%	17.31%	17.57%	17.55%	17.35%	17.13%	17.16%	
HDI	產值	9,222	9,008	9,874	11,811	11,763	10,131	10,795	11,503	12,257	13,061	13,361	5.70%
	佔全球比	14.80%	14.70%	15.10%	14.60%	14.40%	14.57%	14.80%	14.80%	14.64%	14.46%	14.46%	
IC Substrate	產值	7,554	8,139	10,188	14,410	17,415	12,809	14,327	16,024	17,923	20,046	20,720	10.10%
	佔全球比	12.10%	13.30%	15.60%	17.80%	21.30%	18.43%	19.65%	20.61%	21.40%	22.19%	22.42%	
合計		62,396	61,311	65,219	80,920	81,740	69,514	72,921	77,747	83,735	90,348	92,427	5.90%
年增率		6.04%	-1.74%	6.37%	24.07%	1.01%	-14.96%	4.90%	6.62%	7.70%	7.90%	2.30%	

資料來源：Prismark (2023/10) 資料推估。

持續發揮One ZDT綜效

產品面

跨產品線布局多元應用，
與客戶共同開發，提供產
品最佳解決方案。

製造面

多廠區生產基地，因應客
戶需求，靈活彈性調度產
能。

管理面

各廠區分階段導入智能管
理，互相學習優化生產效
率與良率。

人才面

完善的人才培訓及升遷機
制。部份優秀人才調派至
新單位做為種子幹部。

協同客戶共同開發新應用市場

自動駕駛系統



雲端資料中心



低軌衛星



元宇宙





- 基於目前已量產客戶及開發中客戶，臻鼎目標未來五年伺服器應用營收年複合成長率達**雙位數**
- 成長策略：
 - 擴大現有客戶份額
 - Server新平台三大架構全面供應
 - 因應China+1客戶需求，同步認證淮安廠與先豐廠，儲備後續技轉泰國廠
 - 逐步將產品升級由Server跨入Storage/Switch，並開發GPU高階產品



- 臻鼎自許成為汽車自駕化+智能化+電動化的重要推手，在毫米波雷達出貨量市佔達**40%**與高階車用板量產經驗基礎上，未來五年車載板年複合成長率達**雙位數**
- 成長策略
 - 開發ADAS高階應用(4D毫米波成像)雷達板與高階通信模組
 - 供應高階自駕網域控制站全球三大廠家成為策略合作夥伴
 - 擴大現有客戶EV車動力電池軟板份額
 - 新增泰國廠產能布局與國際客戶

四大新廠區為未來成長動能



秦皇島BT載板工廠：FC-CSP/WB-CSP/Memory



深圳 ABF載板工廠：FCBGA



高雄路竹科學園區：軟板與先進模組的生產線



淮安第三園區：高階 HDI/MSAP



地點：泰國巴真府



與當地夥伴策略合作

- 因應客戶需求，完善公司全球化布局戰略。
- 擬選址泰國巴真府。
- 預計2023年12月12日舉行動土典禮，第一期投資金額2.5億美金。
- 預計2025年上半年試生產。



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding



IC載板營運規劃與執行

1

多數BT載板客戶庫存已回到約略正常水位，ABF載板可望在年底觸底回升：

- BT載板客戶庫存天數下降，多數已回到約略正常水位，且公司在耕耘記憶體重要客戶有所斬獲，正向看待BT業務回溫。
- ABF市場在部份應用上仍銷售暢旺，例如: AI、HPC等，整體應在年底有望觸底回升。

2

反映產業供需情形，IC載板產業發展將較原先預期遞延1.5年：

- 整個半導體產業中長期依舊看好，領先廠商如台積電及英特爾，仍持續擴廠。
- IC載板方面，中低階產品新進供應商多，且產能多集中於中國大陸，缺乏國際客戶開拓能力及經驗；中高階產品短期雖有波動，中長期仍有望供不應求。

3

陸續通過國際客戶認證：

- 半導體產業多為國際型客戶，公司陸續取得國際客戶認證，舉凡美系、歐系、日系及陸系客戶皆有佈局，客戶對公司智能化新廠高度認可。

4

聚焦持續開發高密度、細線路產品：

- ABF載板方面，已開始與客戶開發Chiplet使用之高階載板。現出貨18~20層單顆最大尺寸92mm x 92mm產品，僅6個月良率已提升至ABF載板tier 1 供應商水準。未來將進階至20L以上，單顆尺寸100mm x 100mm以上。
- BT載板方面，佈局ETS細線路6/8um，亦為業界tier 1領先水準。

AI應用-Chiplet 小晶片載板

AI

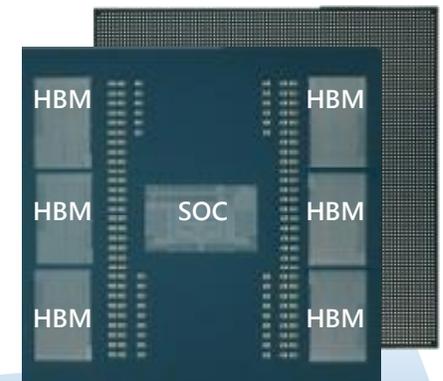


AI應用除需高速運算功能，
還需搭配快速讀寫記憶體空間

晶片解決方案



小晶片載板



載板需求技術

高層數	大尺寸	微孔	細線路	銅面處理技術
✓ 18~20層	✓ 90x90 ~ 95x95mm	✓ 40 ~ 60 um	✓ 9~15 um	✓ 低粗糙度，高結合力

臻鼎
IC載板

車用晶片載板

智能化



網域控制站

- 智駕網域控制站
- 座艙網域控制站

感測器

- 毫米波雷達
- 雷射雷達
- 攝像頭

使用晶片

自動駕駛AI晶片 影像感測器
智慧座艙晶片 存儲晶片
網域控制站DCU晶片 ADAS運算晶片

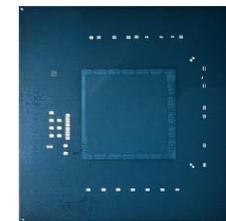


封裝方式

FCBGA
CSP

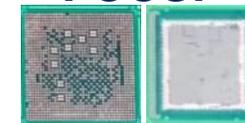
ZDT載板

FCBGA



4~18L
17x17~75x75mm

FCCSP



2~4L
7x7~27x27mm

WBCSP



2~4L
7x7~27x27mm

互聯化



通信模組

- 遠端通訊盒

車聯網

- 5G 模組

智慧座艙晶片



CSP

信息化



顯示系統

- HUD抬頭顯示
- AR/VR虛擬增強現實
- NFC近場通信

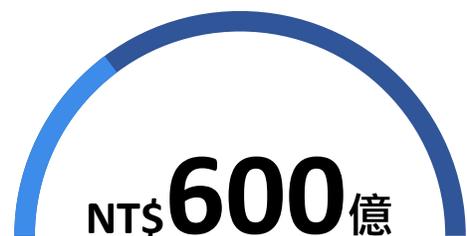
智慧座艙晶片
存儲晶片



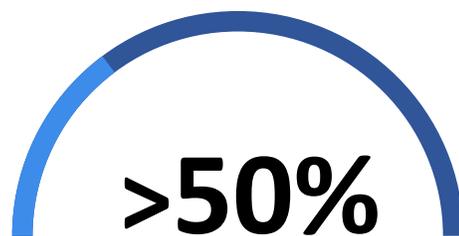
FCBGA
CSP

IC載板產能規劃

		2023				2024				2025				2026			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
深圳 ABF載板 (兩廠樓地板面積共17萬平方米)	Fab 1 (中高階產品)	裝機															
		樣品認證															
		量產，目標良率與tier 1競爭對手相當								產能滿載，目標良率與tier 1競爭對手相當							
	Fab 2 (高階產品)									裝機							
										樣品認證				量產			
秦皇島 BT載板 (兩廠樓地板面積共6萬平方米)	Fab 1	品質領先業界															
	Fab 2	量產				產能利用率60%+				產能利用率80%+							



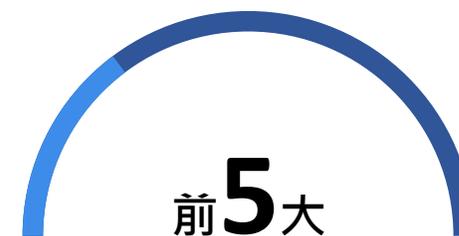
IC載板資本支出：
2022-2027規劃投資600億



IC載板營收：
2023-2027複合成長率 >50%



IC載板營收：
至2027年，IC載板占臻鼎合併營收15%+/-



IC載板市占率：
目標2030年成為IC載板全球前五大



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

Q&A



THANK YOU